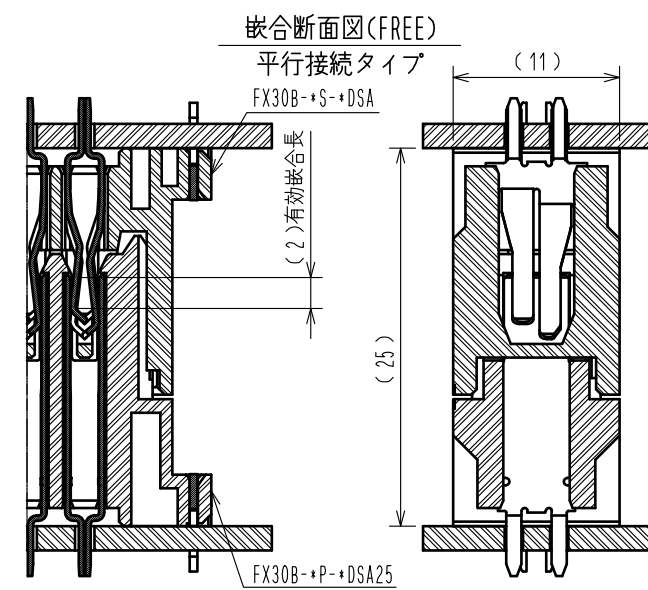
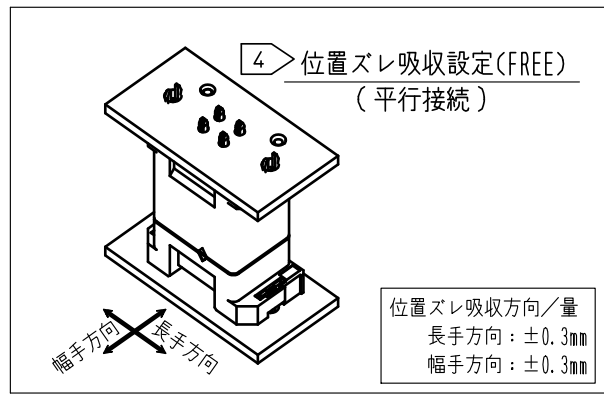


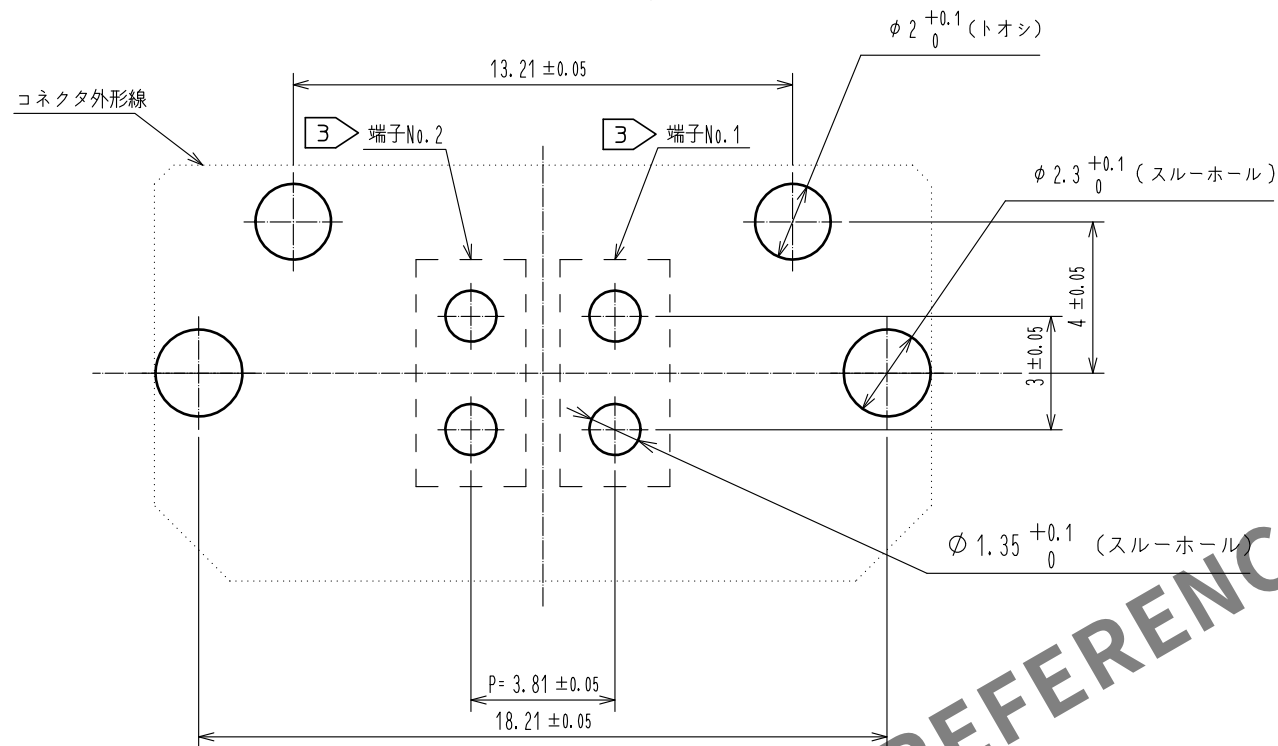


- CAI[®] vs **

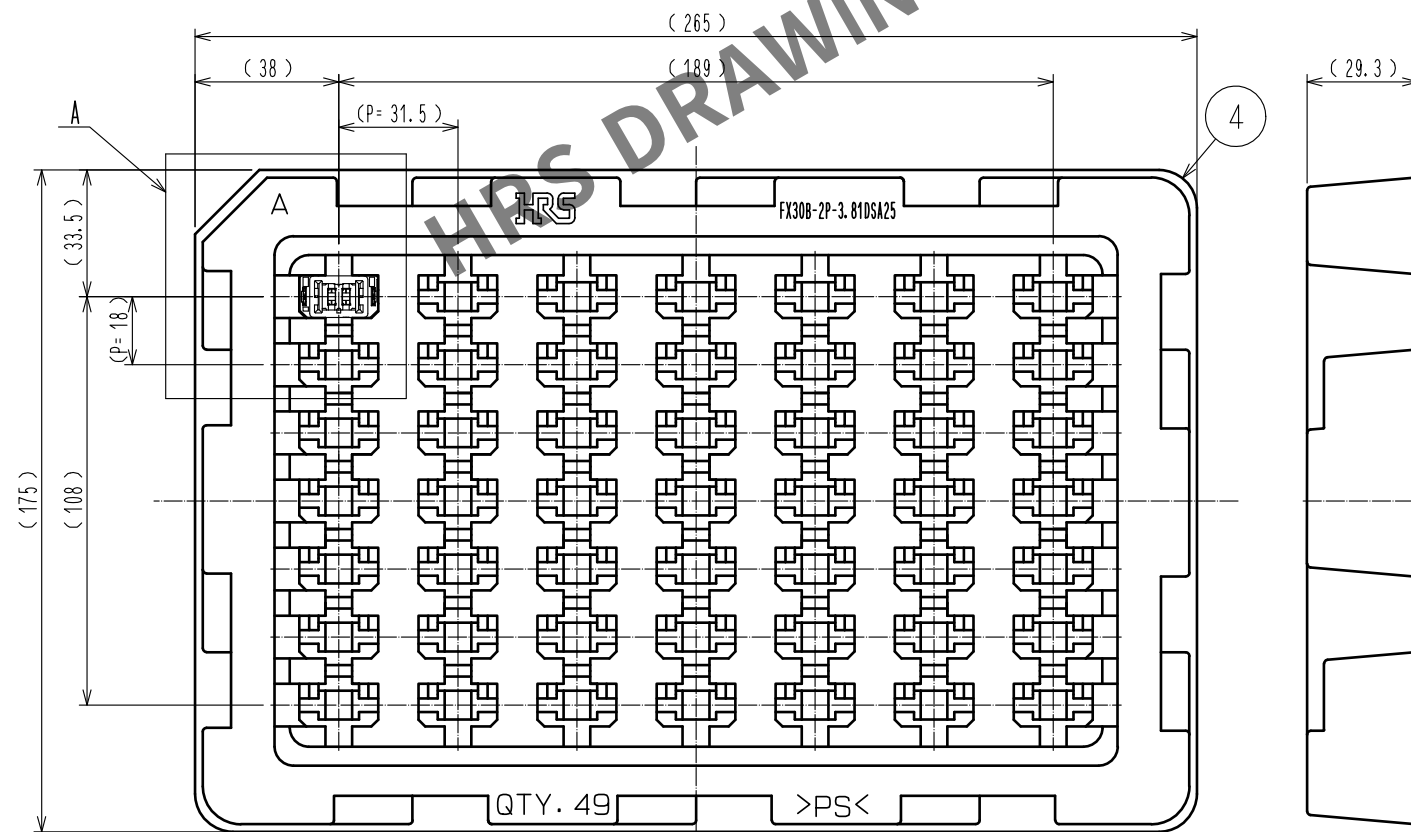
2	銅合金	接触部：金めっき0.1μm		4	ポリスチレン樹脂		
		実装部：すずめっき1.0μm					
		下 地：ニッケルめっき1.0μm					
1	ポリアミド樹脂	クロ UL94V-0		3	りん青銅	全 体：すずめっき3.0μm	
						下 地：ニッケルめっき1.0μm	
部番	材 質	処 理 , 備 考		部番	材 質	処 理 , 備 考	
UNITS mm		SCALE 2 : 1		Δの数 1	訂 正 記 事 DIS-F-00005794		設 計 AK. IWAHORI
						検 図 HT. YAMAGUCHI	年月日 20200212
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : HS. OKAWA 20130313		図番 : ADC3-347259-00			
		検 図 : KI. HIROKAWA 20130312		製品名 : FX30B-2P-3.81DSA25			
		設 計 : DK. AIMOTO 20130311		製品コード			
		製 図 : DK. AIMOTO 20130311		CL570-3200-8-00			

A
B
C
D
E
F

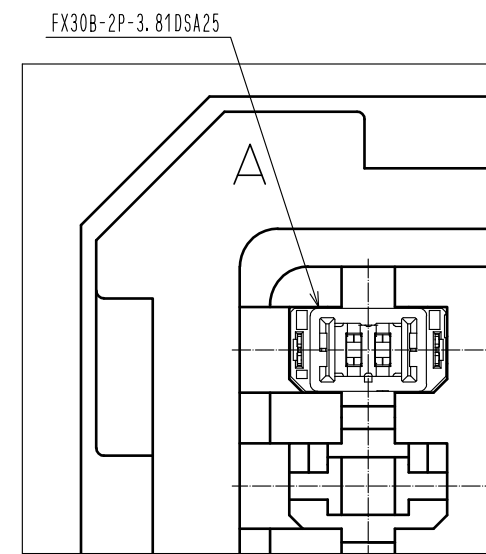
推奨基板穴寸法(5:1)
(コネクタ実装側・推奨基板厚 $t=1.6\text{mm}$)



1> トレー梱包状態図(1:2)



A(1:1)



HRS

図番:	ADC3-347259-00
製品名:	FX30B-2P-3.81DSA25
製品コード	CL570-3200-8-00

A
B
C
D
E
F